



铝基覆铜板

特点：具有高散热性、优良尺寸稳定性、机械强度高，加工性能优良。

用途：功率混合电路；大功率模块；通讯电子电路；LED照明电路；

型号：YGA 系列

产品规格：总厚度： 0.8mm； 1.0mm； 1.2mm； 1.6mm； 2.0mm； 3.0mm

铜箔厚度： 1oz； 2oz； 3oz； 4oz； 6oz

供应尺寸： 1000x600mm； 500x600mm

YGA-4 系列铝基覆铜板性能

项目	处理条件	典型值					
		YGA-4-1	YGA-4-2	YGA-4-3	YGA-4-4	YGA-4-5	YGA-4-6
抗剥强度 (N/mm)	A	≥1.5	≥1.5	≥1.5	≥1.5	≥1.5	≥1.5
	热应力后	≥1.5	≥1.5	≥1.5	≥1.5	≥1.5	≥1.5
表面电阻(MΩ)	A	≥10 ⁶	≥10 ⁶	≥10 ⁶	≥10 ⁶	≥10 ⁶	≥10 ⁶
	C-96/35/90	≥10 ⁵	≥10 ⁵	≥10 ⁵	≥10 ⁵	≥10 ⁵	≥10 ⁵
体积电阻 (MΩ·m)	A	≥10 ⁶	≥10 ⁶	≥10 ⁶	≥10 ⁶	≥10 ⁶	≥10 ⁶
	C-96-35/90	≥10 ⁵	≥10 ⁵	≥10 ⁵	≥10 ⁵	≥10 ⁵	≥10 ⁵
击穿电压 (DC) (KV)	D-48/50+D-0.5/23	≥5	≥6	≥7	≥10	≥12	≥15
介电常数 (1MHZ)	C-96/35/90	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7
介质损耗因数 (1MHZ)	C-96/35/90	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02
热冲击	288℃ 2Min	不分层，不起泡					
燃烧性	A	V-0					
热阻 (℃/W)	Internal T0-220 Test	≤0.45	≤0.60	≤0.70	≤0.80	≤0.95	≤1.1
热导率(W/mK)		2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
CTI (V)	A	600	600	600	600	600	600
Tg (DSC) °C	A	130	130	130	130	130	130

*热阻均为 1.6mm 基材、铜箔厚度 1oz 下的测量值；
热导率是绝缘介质的热导率参数。

深圳市昱谷科技有限公司
TEL: 0755-61511200
FAX: 0755-61511017
Email: sales@yuguchina.com

